

2020 年智能网联汽车与第三代半导体技术 及产业研讨会暨第三代半导体产教融合论坛会议日程

会 议 日 程

时 间	内 容
首届第三代半导体产教融合论坛	
09:30-09:35	背景及嘉宾介绍
09:35-10:00	领导致辞
10:00-10:20	天津滨海高新区产业和投资环境介绍
10:20-10:30	第三代半导体产教融合人才培养实践基地签约
10:30-10:35	聘书颁发
10:35-10:50	第三代半导体技术及产业发展现状及战略 沈 波 北京大学理学部副主任，联盟副理事长
10:50-11:00	合影留念
11:00-11:20	先进电子材料研究进展与发展趋势 陈弘达 中科院半导体所研究员，联盟京津冀协同创新委员会 共同主任
11:20-11:40	第三代半导体产教融合基地建设工作汇报 牛萍娟 天津工业大学电子与信息工程学院常务副院长，联盟 京津冀协同创新委员会副主任
11:40-12:00	半导体企业如何培养人才 邹豈宸 智泽南福企业管理咨询有限公司总经理，原台积电资 深工程师
午 餐	
智能网联汽车与第三代半导体技术及产业研讨会	
13:30-13:50	半导体产业助力智能网联汽车发展 杜志彬 中汽研智能网联技术（天津）有限公司总经理
13:50-14:10	新能源汽车用功率半导体技术解决方案 刘国友 株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师
14:10-14:30	功率半导体在家电的应用

	冯万良 TCL 工业研究院总监
14:30-14:50	碳化硅单晶材料进展与展望 郝建民 中国电子科技集团公司第四十六研究所副总工程师
14:50-15:10	第三代半导体 GaN 器件现状与应用 党冀萍 中国电子科技集团公司第十三研究所首席专家
15:10-15:30	休息
15:30-15:50	新形势下碳化硅单晶衬底的发展现状及市场前景 王 巍 河北同光晶体有限公司副总经理
15:50-16:10	全碳化硅无线充电技术在智能网联汽车中的应用进展 张 献 天津工业大学教授
16:10-16:30	大功率半导体器件封装技术与关键封装材料研究进展徐 菊 中科院电工所研究员
16:30-16:50	高功率密度 SiC 模块可靠封装技术进展 梅云辉 天津工业大学教授
16:50-17:10	碳化硅 MOSFET 器件研究进展及其存在问题分析 桑 玲 全球能源互联网研究院有限公司高级工程师



扫码观看会议直播